

**取扱説明書**  
**HANDLING MANUAL**

---

**SERIES 5602**  
**0.4 mm PITCH B to B CONNECTOR**

						<b>KYOCERA ELCO Corporation ENGINEERING DEPT.</b>
O	EDN-871	6/30 '05				
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED	CHECK	APPROVED	

## 目 次 Contents

1. はじめに Preface .....	2
2. 部品名称及び型番 Parts names and model numbers .....	2
3. 使用に関する注意事項 Matters to be noted in use .....	4

## 1. はじめに Preface

5602シリーズは、市場における高密度実装化に対応すべく開発された0.4mmピッチボードツートードコネクタです。

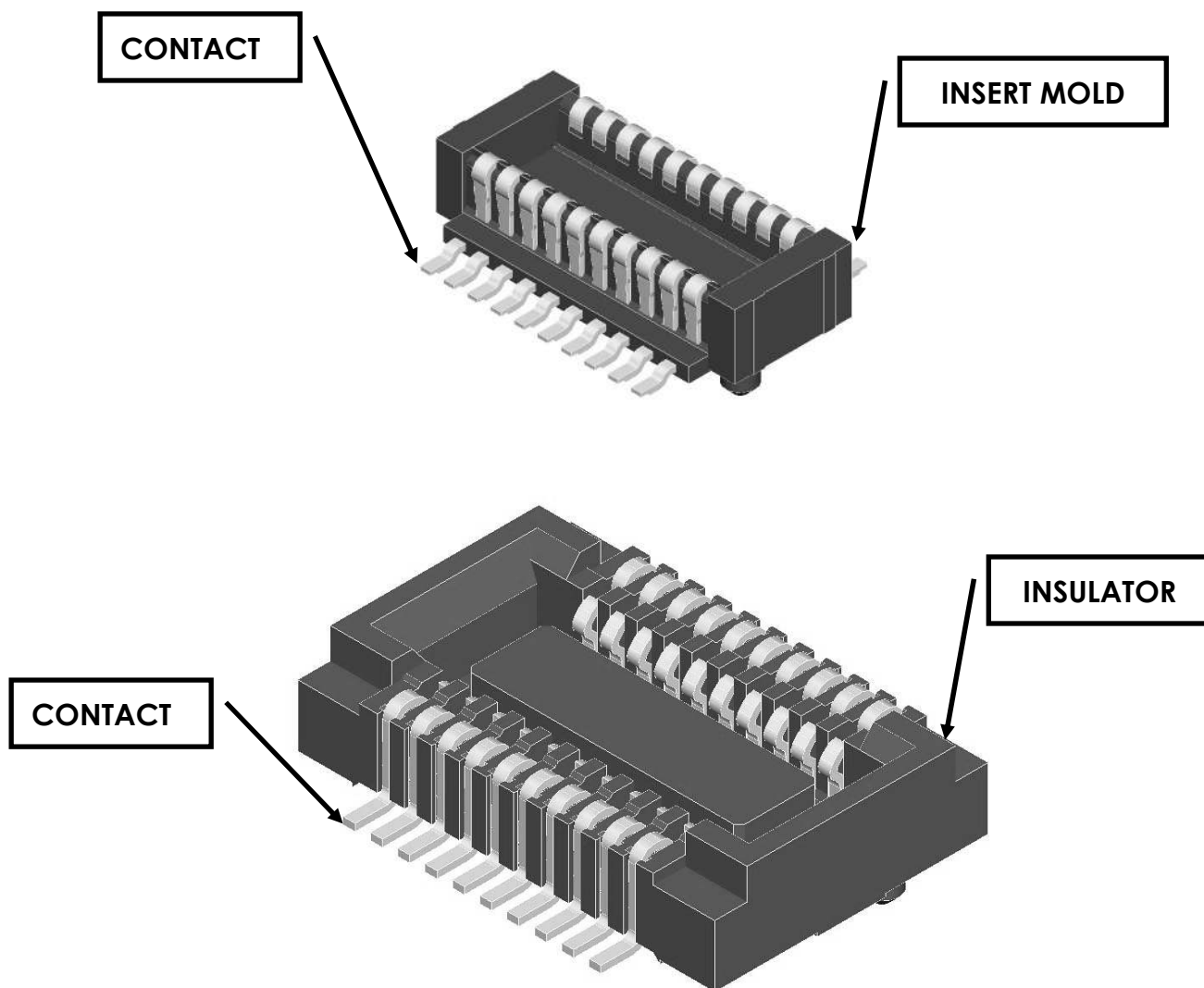
Series 5602 is a board-to-board connector with 0.4mm pitch, developed to meet the market's demand for the higher mountability.

## 2. 部品名称及び型番 Parts names and model numbers

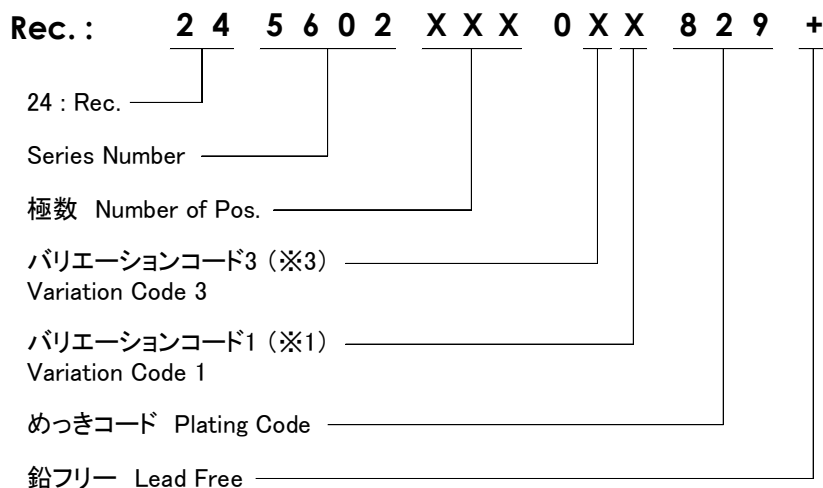
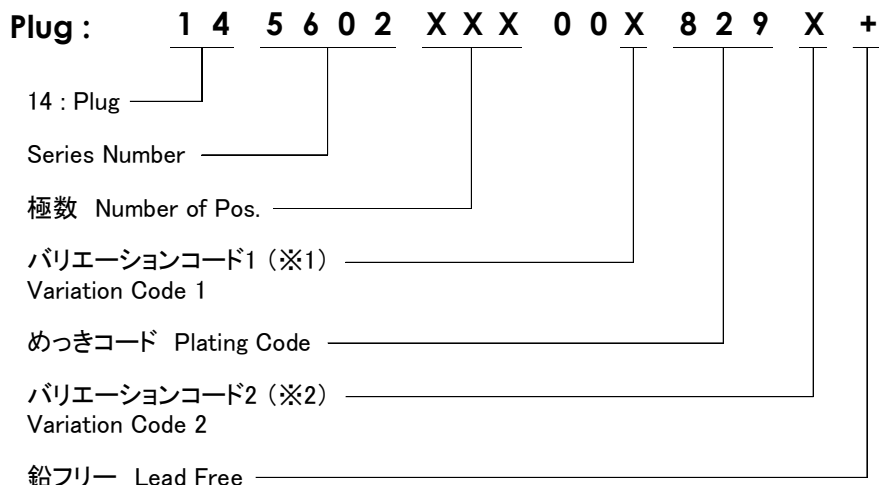
### 2.1 部品名称 Parts names

### SERIES 5602

(0.4mm PITCH B. TO B. CONNECTOR)



## 2.2 型番 Model number



※1 バリエーションコード1  
Variation Code 1

Variation Code 1	金具 Anchor Plate	ボス Boss
0	×	×
1	×	○
2	○	×
3	○	○

○ : あり With    × : なし Without

※2 バリエーションコード2  
Variation Code 2

Variation Code 2	タイプ Type
無	Standard Type
/	Groove Type
H	Twin-Rib Type

※3 バリエーションコード3  
Variation Code 3

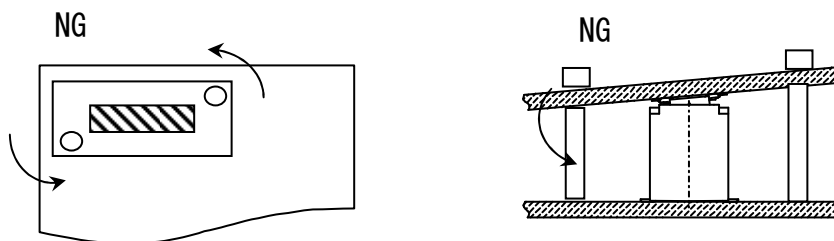
Variation Code 3	嵌合高さ Stacking Height
3	H=2.8mm
5	H=2.0mm

### 3. 使用に関する注意事項 Precautions in handling

#### 3.1 基板での御使用に関して Using the PCB

本製品はコネクタのみでの基板保持は出来ません。コネクタ以外の部位での固定が必要となります。固定の際はコネクタに回転方向や、こじり方向への負荷がかからないように平行に保った状態でご使用ください。

The connector is impossible to support the PCB by itself. The PCB should be supported by something in addition to the connector. The PCB should be supported in order not to apply such forces to the connector as in the direction of turning or twisting.

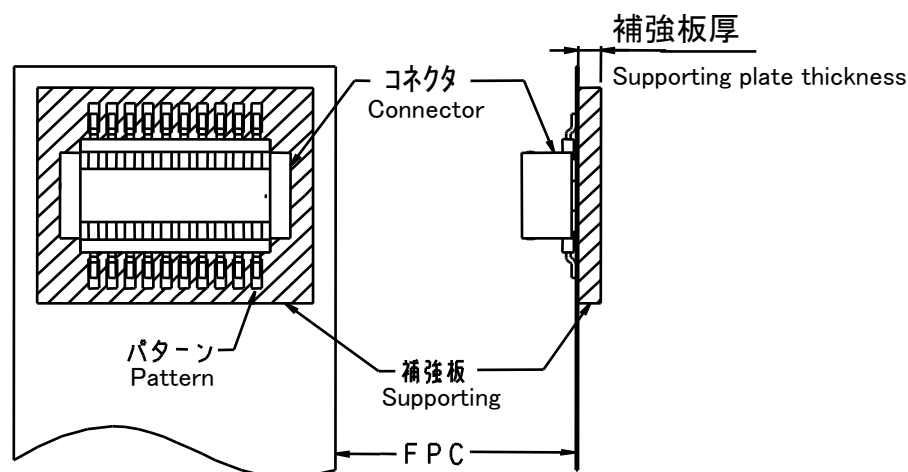


#### 3.2 FPCでの御使用に関して FPC use

(1)コネクタを挿抜する際、製品に直接負荷がかからないように FPC の裏面に補強板を貼り付けた状態での使用をお願い致します。補強板仕様に関しましては弊社製品外形より大きいものを使用し、板厚については実践による確認をお願い致します。

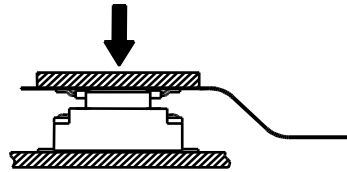
Please make sure to attach reinforcing plate to FPC on its back, so that it will relieve the stress applied to the connector caused by mating.

Such reinforcing plate should be bigger than the connector, and the suitable thickness should be checked practically.



- (2) 落下・衝撃やFPC取り回しの際の反力が大きく加わることが懸念される場合はコネクタの嵌合方向への押さえを設置してください。

When such possibility as the product may fall, receive any impact or reaction force from being thrashed is expected, and then it is recommended to fix them in the direction of engagement.



### 3.3 実装に関して Mounting the connector

- (1) 実装の際には接触部及びテール部に不要な外力が加わり変形等が生じないようにご注意ください。

Please make sure that the connectors are free from deformity caused by the unnecessary stress applied to the contacting points and the tails.

- (2) 自動実装の際には弊社推奨パターン図でのクリームはんだ印刷及び実装をお願い致します。

For the cream solder printing and the automatic mounting, please use the patten diagram of our recommendation.

- (3) クリームはんだ印刷時のスクリーン厚さは0.12mm～0.15mmをお勧め致します。

0.12mm～0.15mm is recommended for the thickness of screen of the cream solder printing.

- (4) 実装条件が弊社推奨リフロー温度プロファイル条件と異なる場合はあらかじめ実装後にコネクタの変形、変色が無いことをご確認の上、実装を行ってください。

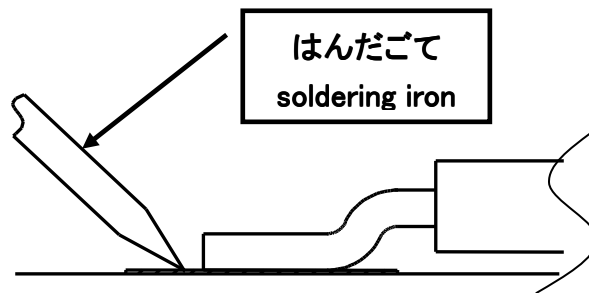
When the mounting condition differs from those of our profile in any way, please make sure that you do not observe any deformity nor color change with the mounted connector before the mounted PCB is installed in the unit.

(5) 手付けはんだの際にはテール部及び基板へのフラックス塗布はしないで下さい。コネクタ内部及び接触部へのフラックス上がり及び飛散の原因となり接触不良等の不具合が発生する場合があります。

又、はんだごてで端子に負荷をかけてはんだ付けを行うとテール部変形及びインシュレータの溶け等の恐れがありますのでご注意願います。

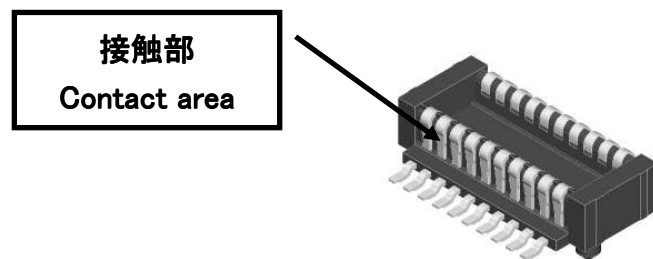
Please do not apply flux onto the tails and the PC board, when soldering by hand. Splattered or migrated flux inside the connector or to the contact points may cause imperfect contact.

Also avoid giving any stress to the tails with the soldering iron. It could deform the tail or melt the insulator.



(7) PLUG 側は接点が外側に露出している為、実装の際はフラックスの飛散にご注意願います。

In the mounting process, special care is needed so that the exposed contact points on the plug side will be free from splattered flux.



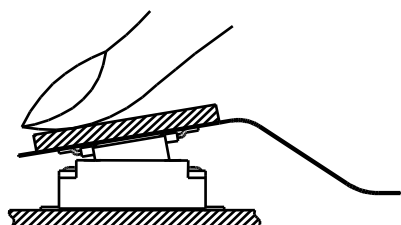
### 3.4 嵌合に関して Mating connectors

(1) コネクタの接触部に触れたり、異物を入れるとバネの変形等の原因となりますのでご注意ください。

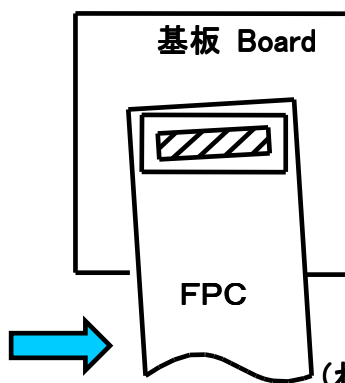
If something touches the contact points or with some foreign object, the spring could be deformed.

(2) 本製品は小型、軽量化をする為に成形品の肉厚を薄くしており、嵌合・離脱時に過度なこじり、ねじり挿抜は成形品の破壊、端子の変形、テール部はんだ剥離の原因となりますのでご注意ください。

We minimized the thickness of this product to achieve downsizing and light weightiness. Because of this, mating and unmating with uneven pressures or in a distorted way could cause destruction of the connector, terminal deformity, or solder peeling from the tail.



(こじり)  
Mating with uneven pressure



(ねじり)  
Mating in a distorted way

(3) 本製品はコネクタのみでの基板保持は出来ません。押さえが無い場合、嵌合のはずれ、テール半田剥離、接触不安定が懸念されます。スペーサーなどをご使用頂き、ねじ止めなどの嵌合の固定が必要です。

The connector is impossible to support the PCB by itself.

Without other supporting objects, imperfect mating, peeling of tails or contacting failure may be caused. As supporting objects, use spacers fixed by screws.

